

技术参数规格书

特性:

- 超薄小型外观
- 专为SMT自动贴片设计
- SKY芯片
- 低正向电压
- 低反向漏电
- 耐瞬间正向浪涌电流冲击
- 高耐焊接温度: 引脚耐焊接热条件为260C/10秒
- 符合EU RoHS 2002/95/1指令要求

外观参数:

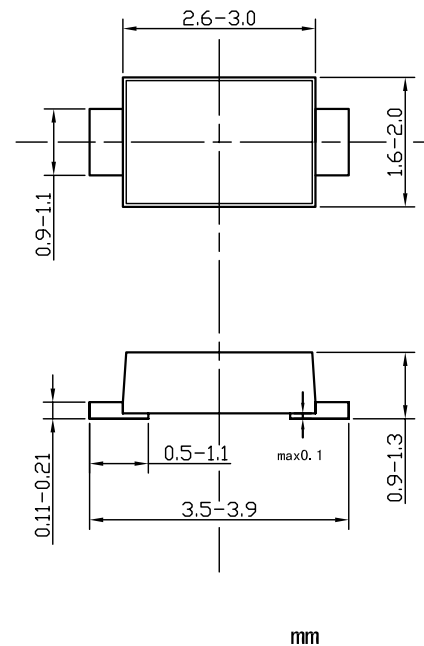
- 封装: 符合JEDEC D0-219AB, 玻璃钝化芯片结合外部塑封
- 引脚: 表面镀锡, 可焊性参照MIL-STD-750, Method 2026
- 标准包装主: 8mm包装带 (EIA-481)
- 极性标志: 激光打印, 阴极标有阴极线条指示

最大额定值与电性能参数:

- 环境温度25C, 除非另有说明
- 单相半波60Hz, 电阻性或电感性负载
- 电容性负载时降低额定电流20%

封装尺寸规格

SOD-123FL



	符号	K12	K13	K14	K15	K16	K18	K19	K110	单位
最大可重复反向电压	V_{RRM}	20	30	40	50	60	80	90	100	V
最大均方根值	V_{RMS}	14	21	28	35	42	56	63	70	V
最大直流阻断电压	V_{DC}	20	30	40	50	60	80	90	100	V
最大正向平均整流电流 @ $T_L = 105^\circ C$	$I_{(AV)}$	1.0								A
峰值正向浪涌冲击电流 8.3ms单一正弦半波	I_{FMS}	30								A
最大正向电压 @ $I_F=1.0A$	V_F	0.55		0.75		0.85				V
最大反向电流	$T_A=25^\circ C$	0.5								mA
	$T_A=125^\circ C$	20		10						
工作结温	T_J	(-55to+150)								$^\circ C$
存储温度	T_{STG}	(-55to+150)								$^\circ C$

典型特性曲线图:

Fig. 1 Forward Current Derating Curve

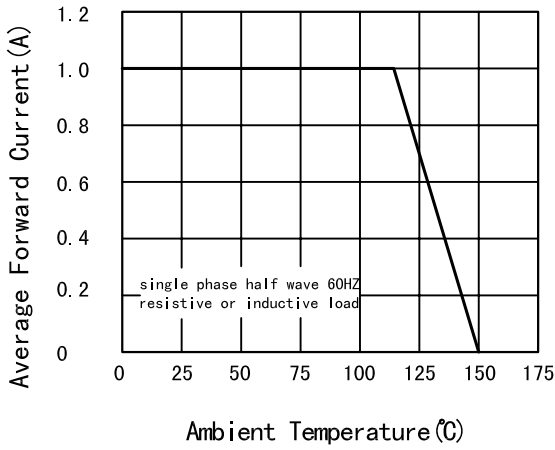


Fig. 2 Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current

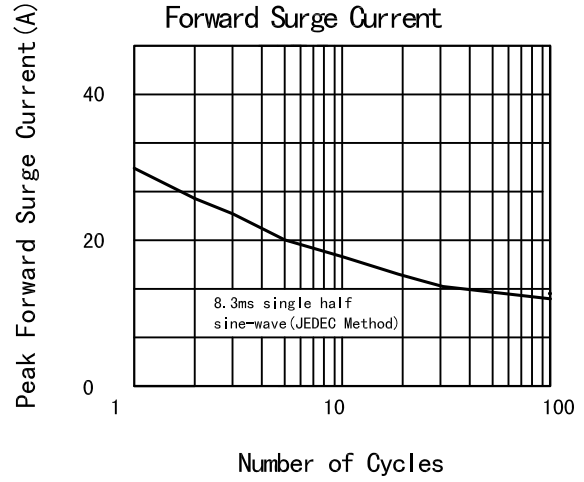


Fig. 3 Typical Instantaneous Forward Characteristics

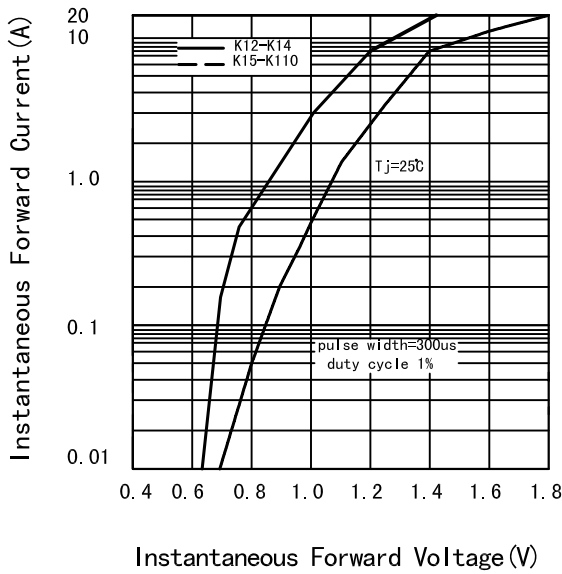


Fig. 4 Typical Reverse Characteristics

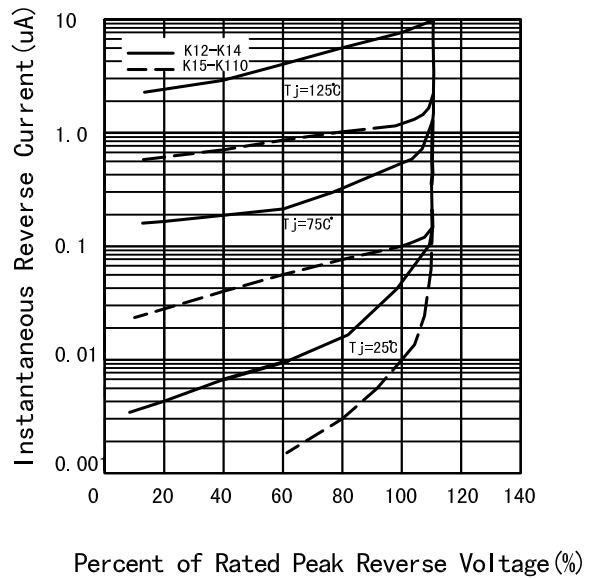


Fig. 5 Typical Junction Capacitance

